

第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在报告中详细披露了可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第二章节“经营情况讨论与分析”中的“四、风险因素”相关内容。投资者注意投资风险。

3、其他披露事项：无

4、公司全体董事出席董事会会议

5、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期间分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。预计2024年归属于上市公司股东的净利润为19,100.00万元，扣除非经常性损益后的净利润为18,945.95万元(含税)。截至2025年3月20日，公司总资产837,901,982.00元，总负债301,900,000.00元，归属于上市公司股东的净资产为636,071,982.00元，以基准股数摊薄后现金分红金额为76,476,838.29元(含税)，占2024年归属于上市公司股东净利润的49.12%。2024年公司不存在不行使本公司现金分红权，不送红股。如在年度报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份(可转债转股/股权激励授予股份的回购/转增股本等)导致公司股本总额发生变化的，公司拟按维持分配比例不变，相应调整利润分配方案。如后述股本发生变动，公司将在权益分派实施前另行公告具体调整情况。

公司2024年年度股东大会决议公告之次周周五(即2024年第二次董事会第八次会议审议)起，尚需根据公司2024年年度股东大会决议，分别分派至公司2024年第一次董事会第八次会议审议，即2024年第三次董事会第八次会议审议，尚需根据公司2024年年度股东大会决议，分别分派至公司2024年第二次董事会第八次会议审议，即2024年第四次董事会第八次会议审议。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简称

√适用 □不适用

公司股票简称：汇成股份

股票上市交易所及板块：上海证券交易所科创板

股票简称：汇成股份

股票代码：688403

变更前股票简称：无

1.2 公司存续状态说明

□适用 √不适用

1.3 股东和实际控制人

董秘姓名：王普

联系地址：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号

电话：0551-67139968-7099

传真：0551-67139968-7099

电子信箱：zhengguan@unisemicon.com

2、报告期公司主要业务介绍

2.1 主营业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为集成电路封装测试服务环节，采用行业惯用的OSAT(半导体封测测试外包)模式，在OSAT模式下，公司业务不涉及集成电路设计环节，专门为集成电路设计公司提供封测服务。

报告期内，公司主要提供显示驱动芯片全制程封装测试服务。在封装服务方面，公司主营业务分为晶圆凸块封装(Bumping)、玻璃覆晶封装(COG)和薄膜覆晶封装(COF)三大制程，并广泛应用于手机、平板电脑、笔记本电脑、平板电脑、汽车电子、智能穿戴、电子标签等领域。

2.2 主要经营模式

(1)盈亏模式

公司属于集成电路行业的封装测试服务环节，采用行业惯用的OSAT(半导体封测测试外包)模式，在OSAT模式下，公司业务不涉及集成电路设计环节，专门为集成电路设计公司提供封测服务。

公司根据客户需求，通过工艺设计、利用封装测试设备，自行购买封装测试原辅料，对客户提供的晶圆进行凸块封装(Bumping)、晶圆COG/COP、玻璃覆晶封装(COF)和薄膜覆晶封装(COF)四大制程进行分拣，将合格的晶圆分类，主要为LCD屏板显示驱动芯片(DID)、触控与驱动集成驱动芯片(TDDI)、AMOLED、OLED屏板显示驱动芯片等，按照终端应用场景，主要分为智能手机、高清电视、笔记本电脑、平板电脑、汽车电子、智能穿戴、电子标签等领域。

2.3 采购情况

采购材料类别后由品质保障部对供应商提供的出货检测报告后进行分类抽检，检验合格后在集中采购系统签收后直接入库。

对于主要采购材料，公司一般会与供应商签订年度协议价，未经年度协议价的则进行比价选定。采购材料按合同要求由物控部门根据合同的制作内容、规格、技术参数、经审核后直接付款。

采购材料类别后由品质保障部对供应商提供的出货检测报告后进行分类抽检，检验合格后在集中采购系统签收后直接入库。

公司根据客户需求，通过工艺设计、利用封装测试设备，自行购买封装测试原辅料，对客户提供的晶圆进行凸块封装(Bumping)、晶圆COG/COP、玻璃覆晶封装(COF)和薄膜覆晶封装(COF)四大制程进行分拣，将合格的晶圆分类，主要为LCD屏板显示驱动芯片(DID)、触控与驱动集成驱动芯片(TDDI)、AMOLED、OLED屏板显示驱动芯片等，按照终端应用场景，主要分为智能手机、高清电视、笔记本电脑、平板电脑、汽车电子、智能穿戴、电子标签等领域。

2.4 销售情况

(1)销售模式

公司的采购模式为按需采购，由物料采购部门统计生产有关的物料耗材需求并编制需求单，根据需求单向供应商下达采购订单。

对于主要采购材料，公司一般会与供应商签订年度协议价，未经年度协议价的则进行比价选定。

采购材料按合同要求由物控部门根据合同的制作内容、规格、技术参数、经审核后直接付款。

采购材料类别后由品质保障部对供应商提供的出货检测报告后进行分类抽检，检验合格后在集中采购系统签收后直接入库。

公司根据客户需求，通过工艺设计、利用封装测试设备，自行购买封装测试原辅料，对客户提供的晶圆进行凸块封装(Bumping)、晶圆COG/COP、玻璃覆晶封装(COF)和薄膜覆晶封装(COF)四大制程进行分拣，将合格的晶圆分类，主要为LCD屏板显示驱动芯片(DID)、触控与驱动集成驱动芯片(TDDI)、AMOLED、OLED屏板显示驱动芯片等，按照终端应用场景，主要分为智能手机、高清电视、笔记本电脑、平板电脑、汽车电子、智能穿戴、电子标签等领域。

2.5 生产情况

(1)生产模式

公司采用大规模生产模式，并建立了相应的销售管理制度。

作为集成电路封装测试企业，公司需要对客户的技术需求进行工艺验证，验证通过后方能与客户开始合作。

公司在取客户订单后完成封装测试服务，并根据客户的具体要求将封装完的芯片交付。公司严格按照客户的具体需求进行工艺验证。

基于客户的需求，公司会根据客户的主要需求由车间采购的材料成本以及根据客户对工艺的要求协商确定加工单据单价，公司产能综合利用率较高，并结合市场供需情况等因素，与客户协商确定。后续也会根据客户的需求特定制化要求，双方协商确定。

金块凸块定价的定价方式是耗用的原材料成本及人工费的综合定价，不同芯片的定价方式，整体定价时衡量客户单片单位面积的良率、可靠性、成本及耗用的原材料量。

晶圆测试、玻璃覆晶封装及薄膜覆晶封装主控是基于不同芯片的具体工艺要求，综合考虑加工设备类型、加工尺寸及市场需求的因素，与客户协商确定。

2.6 研发情况

公司主要自主研发的模块封装对封装测试车间进行研发工作，努力在技术的基础上进行技术创新。

公司自主研发的模块封装对封装测试车间进行研发工作，努力在技术的基础上进行技术创新。

公司自主研发的模块封装对封装测试车间进行研发工作